中原大學 半導體產業學士學位學程		學測、英聽篩選方式			甄選總成績採計方式及佔總成績比例					甄選總成績同分參酌之順序
		第一階段			第二階段					
		科目	檢定	篩選倍率	學測成績採計方式	佔甄選總成績比例	指定項目	檢定	佔甄選總成績比例	
校系代碼	008422	英文 數學A 自然	-- -- 後標	3 -- --	*1.50 *1.50 *1.00	50%	審查資料 面試	-- 60分	30% 20%	一、學測英文級分 二、面試 三、學測數學A級分 四、審查資料
招生名額	36									離島外加名額縣市別限制
性別要求	無									(無)
預計甄試人數	108									
原住民外加名額	無									
離島外加名額	無									
願景計畫外加名額	無									

指定項目甄試費	1000	指定項目內容	審查資料	項目： 修課紀錄(A)、課程學習成果(B、C、D)、多元表現(F、H、J、K、N)、學習歷程自述(O、P、Q)、其他(R.其他有利審查資料) ※項目內容請參照本簡章「貳、分則」乙、審查資料項目內容對照表(第21頁)。 說明： (無)
寄發(或公告)指定項目甄試通知	116.3.30			
繳交資料截止	116.5.5			
指定項目甄試日期	116.5.15 至 116.5.16		甄試說明	1.「審查重點與準備指引」將於116年2月26日前公告於本校問鼎中原網：https://icare.cycu.edu.tw 【大學申請入學專區】 2.考生可於第二階段報名時，於本學位學程訂定之甄試日期中，擇一日之上午或下午時段參與面試。 3.本學位學程第二階段指定項目「面試」採取團體面談方式進行。
榜示	116.5.27			
總成績複查截止	116.5.28			

同級分(分數)超額篩選方式	一、學測英文、數學A、自然之級分總和 二、學測數學A級分
備註	本學位學程於115學年度正式成立，為國內首批專注於半導體領域之專業學士學位學程。課程設計符合工程科技教育認證規範，主要發展方向涵蓋元件整合、製程模組、儀器工程、智慧製造與封裝測試，並緊扣產業趨勢、接軌國際。透過實驗課程、專題研究及產業實習等，培養學生跨領域整合、實務應用與問題解決能力，奠定半導體專業基礎，銜接未來升學及職涯發展。本學位學程網址：https://bpse.cycu.edu.tw/ ※名額內提供1名額弱勢考生優先錄取名額。